

External Laser Small Form Factor Pluggable (ELSFP) 光コネクタ

次世代データセンター接続のためのコンパクトドオプティクス (CPO) ソリューションをサポートする ELSFP 光コネクタシステムは、外部レーザー光源 (ELS) からの光パワーを光チップ接続に効率的に供給する完全なソリューションを提供することで、信頼性を向上させ、現場でのサービス業務をサポートします。ホストとプラグブルモジュール間のブラインド嵌合接続は、耐久性に優れたコンパクトな光接続を提供し、電気接続と組み合わせることでスペース要件を最小限に抑え、信頼性を向上させ、拡張性を最適化できます。

利点と特徴

高密度CPO実装をサポート

コンパクトなフォームファクターがフロントパネルまたはリアパネルからホストシステム内への複雑なファイバー接続を可能にするため、CPOシステムに光パワーを効率的に供給し、データセンターに次世代の拡張性と到達距離を提供することができます。

調達課題を最小限化

ELSFP 光コネクタは、Optical Internetworking Forum (OIF) 準拠の CPO テクノロジーに対応した設計となっており、外部レーザー光源への接続を簡素化し、信頼性を向上させます。相互嵌合機能によって他の OIF ELSFP 準拠ソリューションとの併用が可能になり、サプライチェーンリスクが低減します。

ポートあたりのファイバー数	最大12 (MTフェルール)
ファイバータイプ	偏波保持 (PM) またはシングルモード (SM)
検証	OIF、RoHS、REACH、GR 468、GR 1435、GR 1217 (6.3.3)、TIA-604-5、IEC-61754-7-1

次世代アーキテクチャのスケラブルな導入を実現

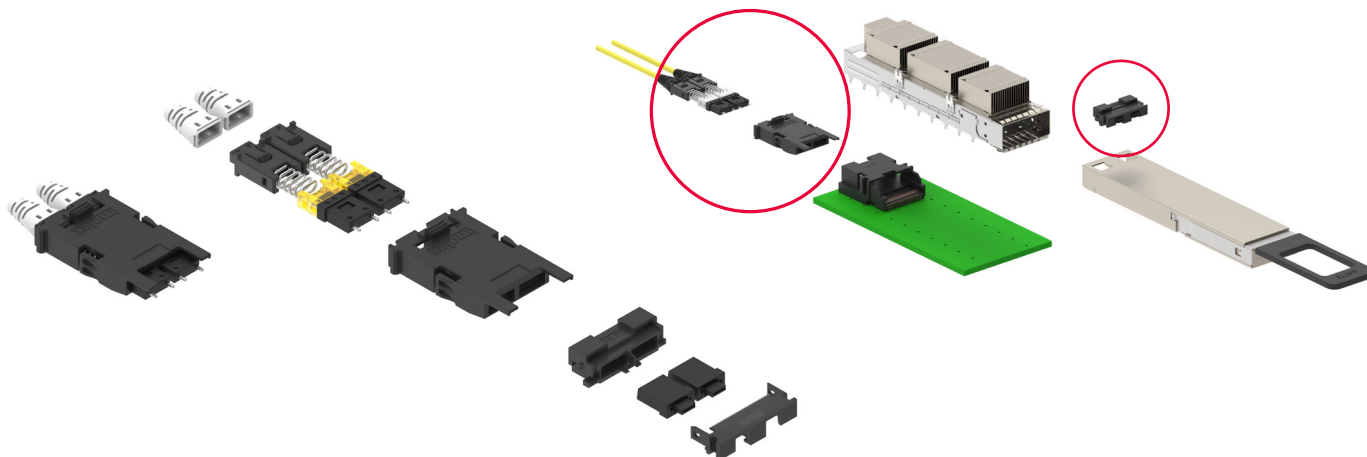
ブラインド嵌合のプラグブルモジュール型ファイバーインターフェースは、アップグレードと拡張を効率化することで CPO 実装の障壁を最小限に抑えます。

ELS 光接続を簡素化

ELS プラグブルモジュールには、光ファイバーを用いて CPO 光学エンジンに結合される高出力連続波レーザーが格納されており、配線上の課題とケーブル敷設の複雑性が軽減されます。

設計と統合作業の効率化

ELSFP システムは、OIF 定義のインターフェースを使用して既知の電気的、熱的、機械的特性を提供するため、テストが簡素化されるとともに、導入時間も短くなります。



External Laser Small Form Factor Pluggable (ELSFP) 光コネクタ ▶

市場と用途

ネットワーク

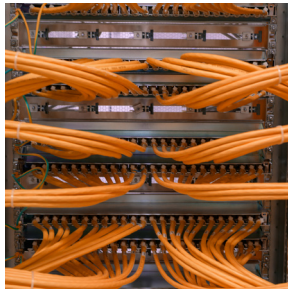
バックエンドネットワーク
高密度ネットワークシステム
スイッチ

サーバーとストレージ

AIおよび機械学習システム
特定用途向け集積回路 (ASIC)
光ファイバーデータセンター
グラフィックス処理装置 (GPU)
ハイパースケールデータセンターの設置

電気通信

ハイパフォーマンスコンピューティングのシステム



スイッチ

ハイパースケール
データセンターの設置ハイパフォーマンス
コンピューティングのシステム

仕様

参考情報

梱包：バッグ
設計単位：ミリメートル
RoHS：はい
低ハロゲン：はい
REACH：はい
OIF：はい
検証：GR 468、GR 1435、GR 1217 (6.3.3)、
TIA-604-5、IEC-61754-7-1

光学的仕様

フェルルタイプ：12ファイバー低損失MT
フェルル数：1~2 (MT)
ファイバータイプ：PMまたはSM
ポートあたりのPMファイバー数：最大12
ポートあたりのSMパススルーファイバー数
(オプション)：最大12

機械的仕様

ケーブルタイプ：ファイバー素線または丸型ケーブル
耐久性 (最小値)：
ケージ/コネクタ — 100サイクル
モジュール — 50サイクル

物理的仕様

相対湿度 (最大)：85%
想定サービス温度：+65°C
動作温度：-5~+70°C
ストレージ温度：-55~+85°C

www.molex.com/ja-jp